2021年3月期（2020年4月～2021年3月）
業績予想に関する説明会

2020年6月18日

内容：

- 事業環境と業績予想　　代表取締役社長・CEO　　河合　利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

  本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

  記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

  当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。したがって、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い影響を受けられたすべての方々に謹んでお見舞い申し上げます。

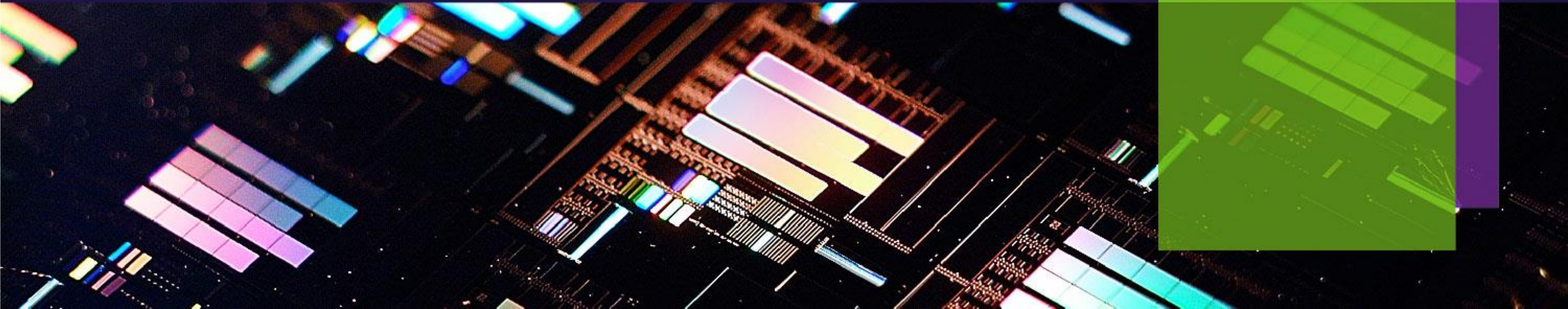
また、このような困難な状況のなか、一日も早く日々の生活を取り戻すためにご尽力いただいている、医療関係者をはじめすべての方々に心よりお礼申し上げます。

代表取締役社長・CEO

事業環境と業績予想

2020年6月18日

河合　利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2020年6月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

CY2020の投資は、前年比10%程度の増加を想定

マクロ経済の動向に注視は必要だが、足元の引き合いは堅調

過去最高のWFE市場規模になると予測

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

TV向け大型パネル投資は継続。モバイル向けOLED投資が回復

CY2020は前年比15%程度の成長を期待

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2020 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- ロジック/ファウンドリ：前年と同程度の高い水準を見込む
  - 市場環境： 先端世代、成熟世代とも需要は堅調
  - 事業機会： 難易度の高まるパターニングでのビジネス拡大
- DRAM：前年比15～20%程度増加
  - 市場環境： 設備投資の約8割が1Ynm以降世代向け
  - 事業機会： 微細化に対応した新たな技術の採用
- 不揮発性メモリ：前年比50%程度増加
  - 市場環境： 生産能力の増強投資が加速
9X/12X層数の世代向けが全体投資の8割以上
  - 事業機会： 高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化

FY2021 業績予想

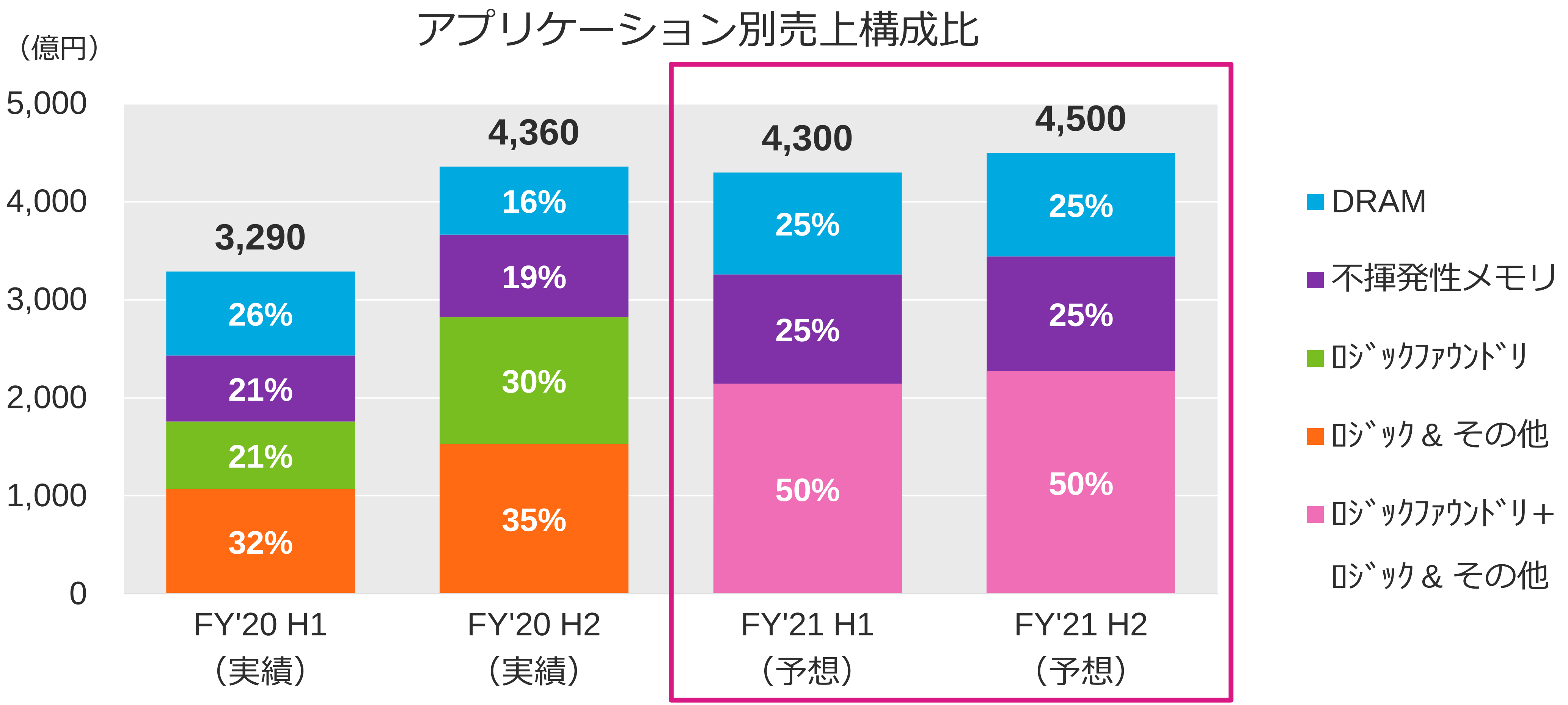
（億円）

	FY2020（実績）	FY2021（予想）			
		H1	H2	通期	通期 対前年増減
売上高	11,272	6,200	6,600	12,800	+13.5%
SPE	10,609	5,850	6,150	12,000	+13.1%
FPD	660	350	450	800	+21.0%
売上総利益 下段：売上総利益率	4,519 40.1%	2,480 40.0%	2,720 41.2%	5,200 40.6%	+679 +0.5pts
販管費	2,146	1,210	1,240	2,450	+303
営業利益 下段：営業利益率	2,372 21.0%	1,270 20.5%	1,480 22.4%	2,750 21.5%	+376 +0.5pts
税金等調整前当期純利益	2,446	1,270	1,480	2,750	+303
親会社株主に帰属する当期純利益	1,852	950	1,100	2,050	+197
1株当たり当期純利益 (円)	1,170.57	610.83	-	1,318.11	+147.54

成長投資を継続しつつ、売上高と利益の増加を目指す

SPE：半導体製造装置、FPD：フラットパネルディスプレイ製造装置

FY2021 SPE部門 新規装置売上予想

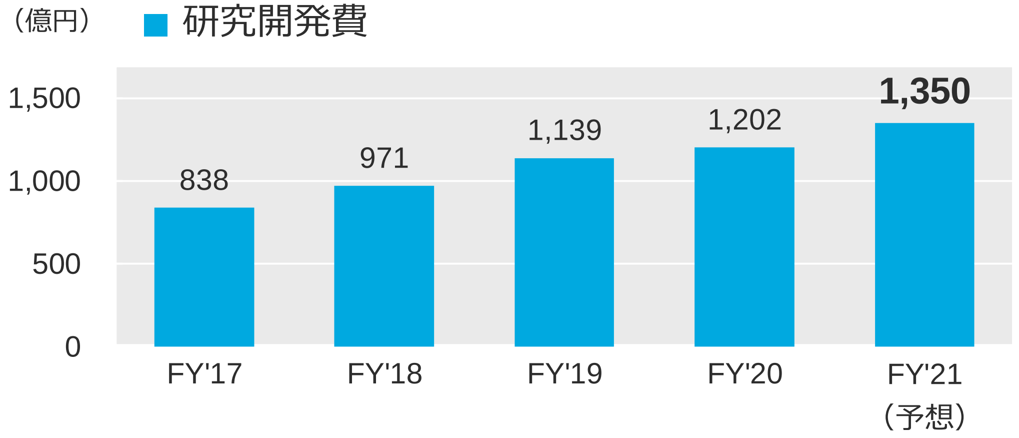


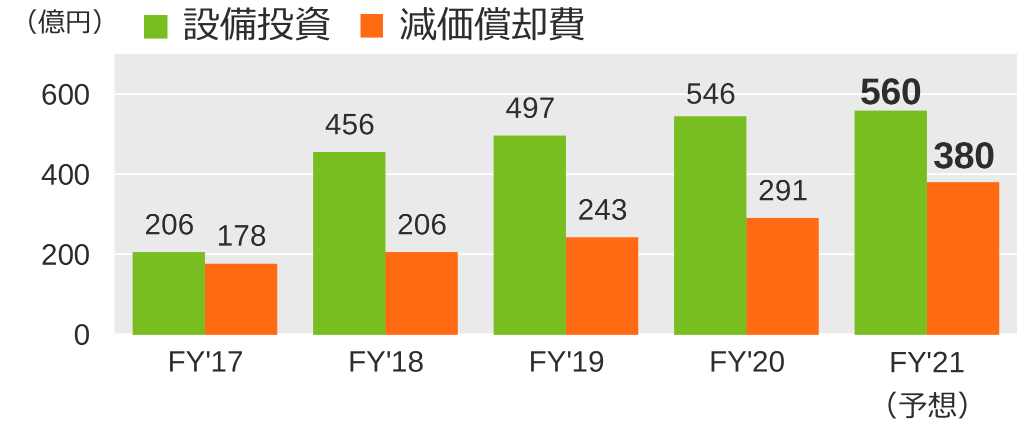
メモリ向け投資の回復に伴い売上は増加

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。
FY2021の構成比予想は概算値です。

FY2021 研究開発費・設備投資計画

- 研究開発費 1,350億円
  - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円
  - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 380億円





新生産棟の建設
（成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム）

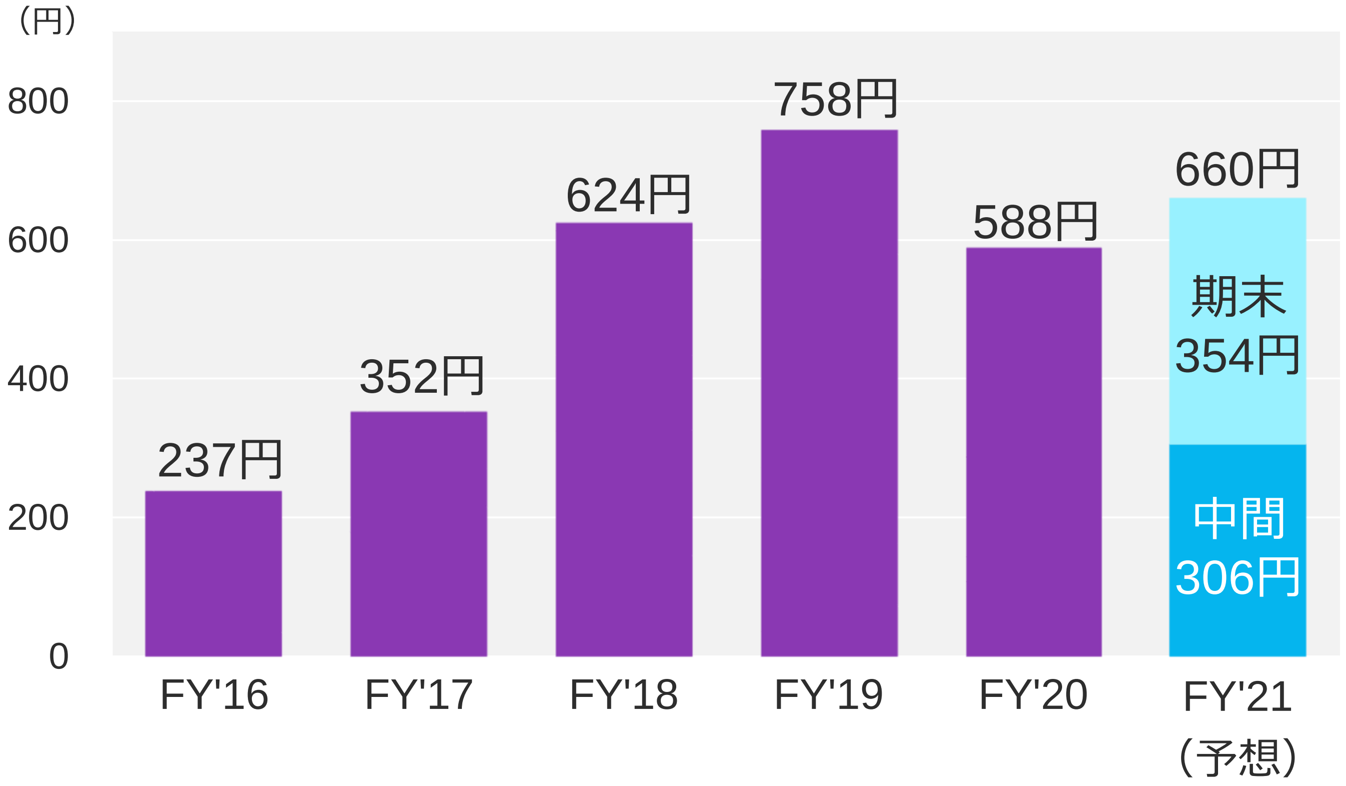
山梨県韮崎市：建設費約130億円
（2020年8月 稼動開始予定）

岩手県奥州市：建設費約130億円
（2020年7月 稼動開始予定）

**将来の成長ポテンシャルを最大限取り込むため、
過去最高の研究開発投資を見込む**

FY2021 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、配当性向 50%に沿って 660円を予定

TEL™

TOKYO ELECTRON